附录B

高度控制测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 附录A | 测量过程名称 | 密封板装配总厚度测量 | 测量过程规范编号 | **Q/XHL001-2014**  |
| 所在部门 | 质量中心 | 测量项目 | 装配总厚度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：（50～75）mm，最大允许误差±0.003mm的数显外径千分尺测量方法：1.先将数显外径千分尺进行校准 1. 测量密封板装配总厚度尺寸：

①采用千分尺测量装置厚度（未装夹试样）②模具冲取试样 ③将试样按照孔位置放置准确后，夹在两块光滑、平整金属板之间，锁紧螺栓，加力55±5N.m ④30min后，采用数显外径千分尺测量总厚度；⑤计算装配总厚度，测量三个试样，取算术平均值为测量结果。环境条件：22℃±2℃测量软件；无操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。其他影响量：无 |
| 有效性确认记录:(采用4等60mm标准量块)用重复测量法对标准量块测量过程进行有效性确认：2020年11月15日用50～75mm数显外径千分尺进行重复性再现性检测，对4等60mm标准块进行检测，取三次测量的平均值为60.002mm（50～75）mm数显外径千分尺的扩展不确定度*U1*为0.007mm；4等60mm标准块*U2*为0.00032mm$ E=\frac{y\_{1}-y\_{2}}{\sqrt{U\_{1}^{2}+U\_{2}^{2}}}$=0.33当E≤1时, 测量过程有效。确认人员：陈辉霞 日期：2020.11.15 |
| 变更记录: |
| 日期 | 变更内容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |